

### Lagenaufbau

| Ebene |  | Komponente | Dicke (mm) | Cu (my) | Typ  |
|-------|--|------------|------------|---------|------|
| 1     |  | Cu+galv.Cu |            | 18+25   |      |
|       |  | Prepreg    | 0.068      |         | 1080 |
|       |  | Prepreg    | 0.068      |         | 1080 |
| 2     |  | Cu         | 0.20       | 35      |      |
|       |  | Tr-Lam     |            |         |      |
|       |  | Cu         |            | 35      |      |
| 3     |  | Prepreg    | 0.068      |         | 1080 |
|       |  | Prepreg    | 0.068      |         | 1080 |
|       |  | Cu         | 0.20       | 35      |      |
| 4     |  | Tr-Lam     |            |         |      |
|       |  | Cu         |            | 35      |      |
| 5     |  | Prepreg    | 0.068      |         | 1080 |
|       |  | Prepreg    | 0.068      |         | 1080 |
|       |  | Cu+galv.Cu |            | 18+25   |      |

|                                               |      |         |
|-----------------------------------------------|------|---------|
| Presslingsdicke *                             | 0,96 | +/- 10% |
| Gesamtdicke inkl. galv. Cu u. Lötstopmmaske * | 1,07 | +/- 10% |

### Bemerkungen zum Lagenaufbau:

- \* Dickenberechnung mit Basismaterial FR-4 ungefüllt bei 50% Kupferbelegung auf Innenlagen (abhängig von Basismaterialtyp, gewählter Kupferdicke und Kupferbelegung abweichende resultierende Isolations- und Enddicken)
- Dickentoleranz Basismaterial +/-10%
- minimale Kupferenddicken gemäß IPC 6012 aktuelle Ausgabe

### Designrules zum Lagenaufbau

|                                |                                     |          |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------|
| Durchgangslöcher [A]<br>(Vias) | End-Ø                               | ≥ 150 µm |
|                                | Viapad-Ø                            | ≥ 450 µm |
| Leiterbild Außenlagen          |                                     |          |
| Standard                       | Leiterbreite bei 9 µm Grundkupfer   | ≥ 80 µm  |
|                                | Leiterabstand bei 9 µm Grundkupfer  | ≥ 100 µm |
|                                | Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer  | ≥ 100 µm |
|                                | Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer | ≥ 120 µm |
|                                | Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer  | ≥ 130 µm |
|                                | Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer | ≥ 175 µm |
|                                | Leiterbreite bei 70 µm Grundkupfer  | ≥ 190 µm |
|                                | Leiterabstand bei 70 µm Grundkupfer | ≥ 240 µm |
| Leiterbild Innenlagen          |                                     |          |
|                                | Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer  | ≥ 65 µm  |
|                                | Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer | ≥ 80 µm  |
| Standard                       | Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer  | ≥ 85 µm  |
|                                | Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer | ≥ 100 µm |